Kiru Kezuru Migaku

DISCO

Grinding Wheels

GS08 SERIES

SiCウェーハの高品位研削を可能にしたグラインディングホイール

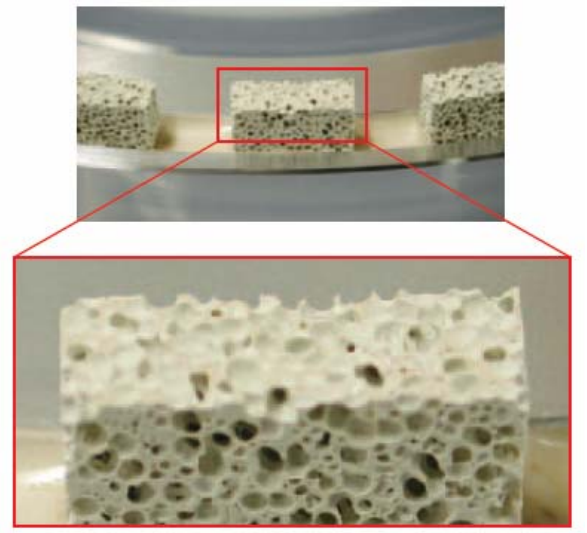
多孔質ビトリファイドボンドを採用し、固定砥粒によるSiCウェーハの高品位研削を実現

GS08シリーズは、高硬度のSiCウェーハを研削するため、切り粉の排出能力・研削水供給の優れた新開発多孔質ビトリファイドを採用し、固定砥粒による研削加工でポリッシュに近い面粗さを実現するグラインディングホイールです。テープに貼り付けた状態での研削が可能で、ワックスによる基板への貼り剥がしが不要なため、スラリーを使用するプロセスに比べ容易なオペレーションが実現できます。

- ●固定砥粒での研削で、ポリッシュに近い面粗さを実現
- ●テープに貼り付けた状態での研削が可能なため、オペレーションが容易
- ●スラリー不要で、環境負荷が少ないプロセス

■多孔質ビトリファイドボンド

GS08シリーズは、独自のアイディアから生まれた新開発の多孔質ビトリファイドボンドを採用しています。



加工対象	炭化珪素(SiC)、アルミナセラミックス、窒化珪素、他

仕様

GS08 － SE0126 200 × 3.5 W × 4.5 T － SR

品種	
SE0126	標準タイプ
SA0135	ファインメッシュタイプ

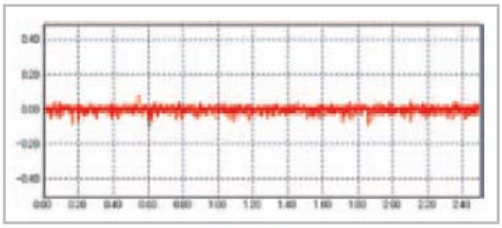
ホイール径
200 (mm)

チップ幅	チップ高さ
3.5	4.5
3.5	3.5
(mm)	(mm)

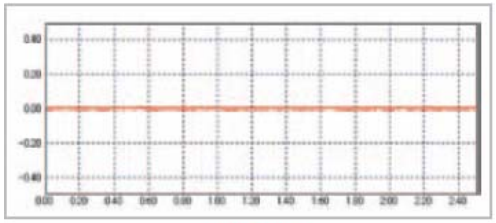
チップ表記	チップ形状	チップ配列
SR	セグメント	真円

実験データ

■SiC研削時の面粗さ



SE0126
(標準タイプ)



SA0135
(ファインメッシュタイプ)

使用ホイール	SE0126 (標準タイプ)	SA0135 (ファインメッシュタイプ)
Ra (μm)	0.011	0.001
Ry (μm)	0.115	0.009

ワーク　：ø3” SiCウェーハ
測定器　：接触式面粗さ測定器

弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

ご注文に際して

タイプ名・外径・厚さ・内径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当員が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械（装置）その他諸条件を詳しくお知らせください。

・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますので、ご確認の上ご発注くださいますようお願い申し上げます。

⚠ 安全にご使用いただくために

ブレード、ホイール（以下、精密加工ツール）の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- ●安全カバー（ノズルケース、カバー）を使用してください。
- ●制限回転数表示のある精密加工ツールは指定の回転数を超えて使用しないでください。
- ●精密加工ツールを装着する際は機械（装置）の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- ●精密加工ツールを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ●使用する際には必ず毎回精密加工ツールを確認して、欠けやその他破損がある場合は使用を中止してください。
- ●ご使用の機械（装置）の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ●改造された機械（装置）は使用しないでください。
- ●機械（装置）指定サイズに合わない精密加工ツールは使用しないでください。
- ●切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- ●湿式切断の精密加工ツールは冷却液をご使用ください。

DISCO CORPORATION
www.disco.co.jp

2014.11